

第4回半導体デバイスプロセス技術基礎講座 2023

【ナノインプリント技術の基礎と今後の技術動向】

主催：大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所

https://www.omu.ac.jp/orp/org/crc/semicon_tech/

協賛：エレクトロニクス実装学会、応用物理学会シリコンテクノロジー分科会、CVD研究会、
化学工学会エレクトロニクス部会、化学工学会反応工学部会CVD反応分科会

後援：近畿経済産業局

日時：2024年2月22日（木）16:00～18:50

開催場所：大阪公立大学 I-site なんば 2階 C2&C3 / A1&A2（名刺交換会・技術交流会）

<https://www.omu.ac.jp/isite/access/>

講師：大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所 平井 義彦 氏

講演概要：半導体デバイスをはじめとする先端デバイスの産業化には、低コストで高効率の微細加工技術が求められる。ナノインプリント法は、従来のビーム系リソグラフィ技術に代わる半導体加工技術として提案され、実用化が検討されている。一方、従来技術では実現できない多様な材料や形状への応用が可能であり、半導体分野以外への展開も期待されている。ここでは、ダイレクト(熱)ナノインプリント、UV ナノインプリント、離型プロセスの基礎について述べるとともに、先端半導体の応用、メタサーフェスなどの光学デバイス、バイオメティックスなどの表面機能デバイスへの応用例について、ナノインプリントの特徴と関連付けて概説する。さらに、今後の展開と半導体チップレットへの応用を紹介する。

プログラム（若干時間が前後することがあります）

- 16：00～16：10 開催の挨拶
- 16：10～18：45 セミナー（途中休憩と質疑応答を含む）
- 18：45～18：50 閉会
- 19：00～20：00 名刺交換会・技術交流会



申し込み用 QR コード

- * 定員 100 名(先着申込順)
- * 参加費「無料」
- * 申し込みは、右の QR コードもしくは下記の URL からお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Ee3GnmpyuXDhwHL9Whm7o9tw2p3k5APKnnR5oGuA69-D9g/viewform?vc=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

- * 申し込み締め切り：2024年2月16日（金）
- * 問合せ先：大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所
TEL.: 072-254-9821 e-mail: semicon.tech.omu@gmail.com

* 謝辞 本講座運営の一部は公益財団法人 東京応化科学技術振興財団から補助されています

